

第49回 エンジニアリングセラミックスセミナー

「ナノからミクロスケールの3次元構造評価の最新技術」

セラミックスの特性はその構造に大きな影響を受けます。近年の観察・評価技術の進歩は著しく、表面観察だけでなく、ナノからミクロまでのマルチスケールでの3次元構造評価が可能になり、その物質に関する実質的で高精度な情報を得ることができます。これらはセラミックスのプロセスの設計や部材の開発、および、作製したデバイスや部材の非破壊評価にも非常に有効だと考えられます。本年度のセミナーでは、企業および研究機関から、これらの評価技術に精通される方々を講師に招き、各スケールでの様々な評価技術を紹介していただくとともに、セラミックスへの適用の可能性についてもご講演いただくことにしました。普段の学会や講演会では得ることのできない研究開発に対するヒントやアイデアを発見できる良い機会と思いますので、セラミックス研究分野の方のみならず、多方面からの多くの皆様のご参加をお待ちしております。

主催：日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会

協賛：耐火物技術協会、日本化学会、日本金属学会、応用物理学会、粉体粉末冶金協会、粉体工学会、日本顕微鏡学会（予定）

開催日時：2017年10月24日（火）

場所：東京工業大学 田町キャンパス キャンパス・イノベーションセンター 国際会議室
東京都港区芝浦3-3-6（URL: <http://www.cictokyo.jp.index.html>）

JR 田町駅芝浦口から徒歩1分、都営地下鉄浅草線・三田線 三田駅から徒歩5分

定員：100名

参加費：会員 13000円（協賛学協会含む）、学生会員 6000円、非会員 15000円
（申込時入会は会員扱）、（消費税・テキスト代込）

申込方法：HP（http://www.ceramic.or.jp/bkouon/index_j.html）の申込フォームよりお申し込みください。参加費はセミナー前日までに銀行振込にてご送金ください。お申込後の取り消しによる返金はいたしません。

問合せ先：〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17

公益社団法人 日本セラミックス協会 エンジニアリングセラミックス部会

TEL: 03-3362-5231, FAX: 03-3362-5714 Email: encera@cersj.org

振込先：三菱東京 UFJ 銀行 千里中央支店（普）0073211（公社）

日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会 名義
銀行振込の振込受領書を領収書にかえさせていただきます

プログラム

- 13:30～13:35 開会挨拶
エンジニアリングセラミックス部会 部会長 日本特殊陶業（株）水野賢一
- 13:35～14:20 「セラミックスの3次元ナノ解析」（仮）
九州大学大学院 金子賢治
- 14:20～15:05 「直交型 FIB-SEM によるナノスケール三次元構造解析」
（株）日立ハイテクノロジーズ アプリケーション開発部 生頼義久
- 休憩
- 15:20～16:05 「超音波映像装置による測定事例と最新機能の紹介」（仮）
（株）日立パワーソリューションズ 大野茂
- 16:05～16:50 「磁場顕微鏡と3次元X線顕微鏡による非破壊解析」（仮）
東芝ナノアナリシス（株） 照井裕二
- 16:50～17:35 「マイクロCTのセラミックス製造プロセスへの応用」
長岡技術科学大学 田中諭
- 17:35 閉会挨拶
エンジニアリングセラミックス部会 副部会長 東京大学 幾原雄一